

### 特性

- 》良好的热传导率: **3.0 W/mK**
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高可压缩性, 柔软兼有弹性, 适合于低压力应用环境
- 》可提供多种厚度选择

### 应用

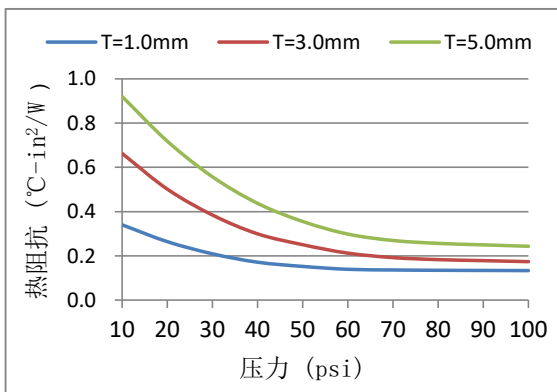
- 》散热器底部或框架
- 》机顶盒
- 》电源与车用蓄电池
- 》充电桩
- 》LED电视、灯具
- 》显卡模组

**TIF™100-30-11ES**是一种填充发热器件和散热片或金属底座二者之间的空气间隙。它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上, 从而提高发热电子组件的效率和使用寿命。

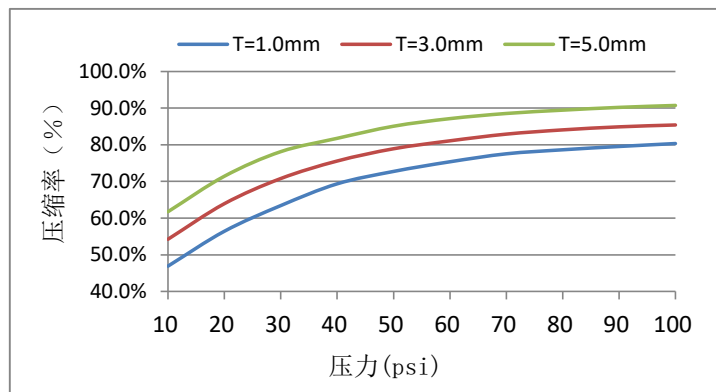
TIF™100-30-11ES 系列特性表

颜色	灰色	Visual
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶	*****
厚度范围	0.020"(0.5mm)~0.200" (5.0mm)	ASTM D374
硬度	12 Shore 00	ASTM 2240
比重	2.9 g/cc	ASTM D297
使用温度范围	-40~160°C	*****
击穿电压(T= 1mm 以上)	>5500 VAC	ASTM D149
介电常数@1MHz	4.0 MHz	ASTM D150
体积电阻率	1.0X10 <sup>12</sup> Ohm-cm	ASTM D257
热传导率	3.0 W/mK	ASTM D5470
	3.0 W/mK	GB-T32064
总质量损失 (TML)	0.35%	ASTM E595
防火等级	94 -V0	UL E331100

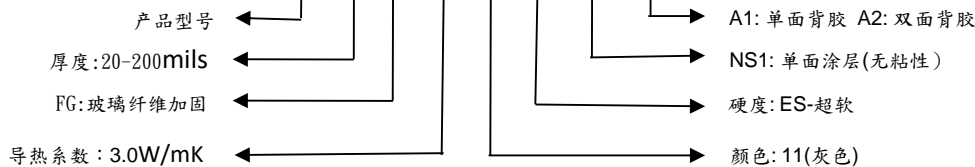
### 热阻抗



### 压缩率



### 产品型号说明: TIF1 00 FG - 30 - 11 ES - NS1 - A1



导热介面材料  
应用技术下载



<http://www.ziitek.com>

### 产品规格

标准厚度: 0.020"(0.5mm)~0.200" (5.0mm)

标准尺寸: 8"×16" (203mm×406mm)

TIF系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度请与本公司联系。欲了解更多导热材料的产品信息, 请与本公司联系。

### 导热材料

### 发热材料

### 导热工程塑料

### 发泡硅胶

### 模切制品

加拿大:  
Tel: +001-604-2998559  
E-mail: sales@thermazig.com

中国:  
Tel: +86-769-38801208  
E-mail: frances@ziitek.com.tw

台湾:  
Tel: +886-2-22771007  
E-mail: frances@ziitek.com.tw